

300mmウエハー工場建設で

中国・上海市で300mm口径の半導体用シリコンウエハーの製造を計画する上海芯森半導体科技に出資する上海新陽半導体材料(上海市松江区思賢路3600号)は9月初旬、ウエハー工場の建設や開発費用のため、第三者割当増資で3億元(約49・2億円)を調達する計画を発表した。

半導体の組立時に使われる液や封止樹脂のバリ取り用洗浄剤などを生産する

プリント(興森快捷電路科技、広東省深圳市)とSOIやエビウエハー製造のシムグレイ(新傲科技、上海市嘉定区)などと半導体用ウエハーを製造する「上海芯森半導体科技」を設立。芯森半導体科技は今後、上海の浦東新区臨港地区の書院鎮に300mm口径のシリコンインゴットとウエハー工

ゴットとウエハーの製造技術を開発し、新工場の建設資金の一部に充当する。すでに約10万㎡の工場用地を取得済み。工場の建設費用は18億元(約295億円)を見込む。将来的に300mmウエハー月産能力15万枚の規模を計画しており、生産開始は2016〜17年になるとみられる。

ボンダービジネスの次世代戦略

白鳥 俊幸氏

アルファードesign(株) 半導体実装プロジェクトリーダー

白鳥俊幸氏に話を伺った。まずはプロジェクト発足の経緯を。

白鳥 半導体パッケージ技術の複雑化に伴い、

超マルチヘッドで生産性9倍に向上

3年後に売り上げ3倍に



アルファードesign(株)
(長野県東御市滋野甲2
211-3、☎0268
64-0008)は、

現在装置メーカーにもプロセスを含めた提案力が求められており、事業展開に一貫性を持たせることが目的だった。営業と企画、そして技術のそれぞれの部門が別々に活動するのではなく、密接に連携することが重要だと思っている。

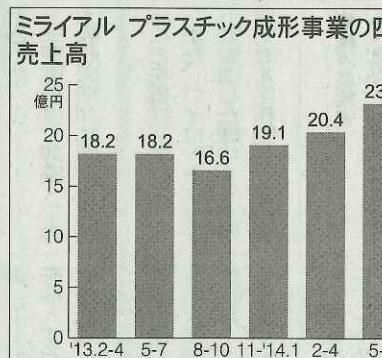
白鳥 6ヘッドによる個別加熱・加圧が可能なのが最大の特徴だ。TCB工法は圧着・加熱・

冷却の工程が一番時間を要してしまう。拘束される時間をなるべく少なくするため、仮搭載をまず別のFCボンダーで行い、その後一気にTCBを行うという手法だ。

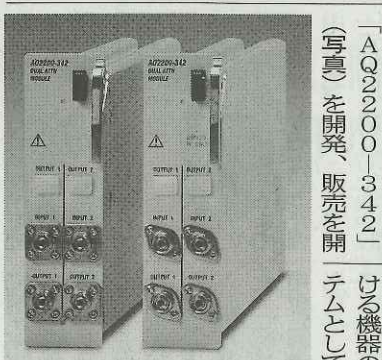
白鳥 ME Sでの発表以後、大手メーカーからの反響が数多く寄せられており、「方向性は間違っていない」と確信すること

白鳥 装置の開発、販売を開くためには、顧客へのサポート体制はまだ不十分であり、今後改善

白鳥 今後の課題は、装置のコンセプトやスペックには自信を持っていて、顧客へのサポート体制はまだ不十分であり、今後改善



一方で、短期的には8〜10月期以降からウエハー市場が再度調整局面に突入り、FOSBのリユース率も上がっているため、下期の業績は厳しい



「AQ2200-342」ける機器の試験・検査システムとして有効利用することができると特徴は大きく3つ。1つは従来と同様の1スロット幅のモジュールに、2台分の光減衰器の機能を搭載し



白鳥 ME Sでの発表以後、大手メーカーからの反響が数多く寄せられており、「方向性は間違っていない」と確信すること

白鳥 今後の課題は、装置のコンセプトやスペックには自信を持っていて、顧客へのサポート体制はまだ不十分であり、今後改善

聞き手・稲葉雅巳(記者)